DATENBLATT

DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 15 LPIII/Z



Beschreibung

Die 15-polige D-Sub Buchse in flacher Bauform von EFB-Elektronik ist für eine zuverlässige Schneidklemmenverbindung ausgelegt. Mit 180°-Anschlusswinkel und weiblicher Kontaktausführung eignet sie sich für kompakte Steckverbindungen mit flachem Kabel in technischen Anwendungen.

- 15-polige D-Sub Buchse in flacher Bauform
- 180°-Ausführung mit Schneidklemme für die Leiteranbindung
- Weibliche Kontaktausführung für passende Steckverbindungen

Durch den Temperaturbereich von -25 bis 85 °C ist die Buchse für Anwendungen mit erhöhten Umgebungsanforderungen ausgelegt. Die Ausführung EDFF 15 LPIII/Z unterstützt eine stabile Signalverbindung bei Leiterquerschnitten von 28AWG bis 26AWG und bei Anwendungen, in denen eine kompakte und dauerhaft belastbare Schnittstelle erforderlich ist.

Technische Details
- Typ: EDFF 15 LPIII/Z
- Anschusswinkel: 180°
- Ausführung: Buchse
- Für Kabeltyp: flach
- Kontaktausführung: weiblich (female)
- Leiterquerschnitt: 28AWG ~ 26AWG
- Polzahl: 15
- Temperaturbereich: -25 – 85 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 70 Stück pro Blister

Technische Eigenschaften

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 15 LPIII/Z

Anschlussart	sonstige
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Buchse
Für Kabeltyp (rund/flach)	flach
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanzt)	gestanzt
Kontaktausführung	weiblich (female)
Leiterquerschnitt	28AWG ~ 26AWG
Temperaturbereich	-25 – 85

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
29010.1	DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 09 LPIII/Z	9	EDFF 09 LPIII/Z	90 Stück pro Blister	2
29011.1	DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 15 LPIII/Z	15	EDFF 15 LPIII/Z	70 Stück pro Blister	2
29012.1	DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 25 LPIII/Z	25	EDFF 25 LPIII/Z	40 Stück pro Blister	2

Zeichnungen

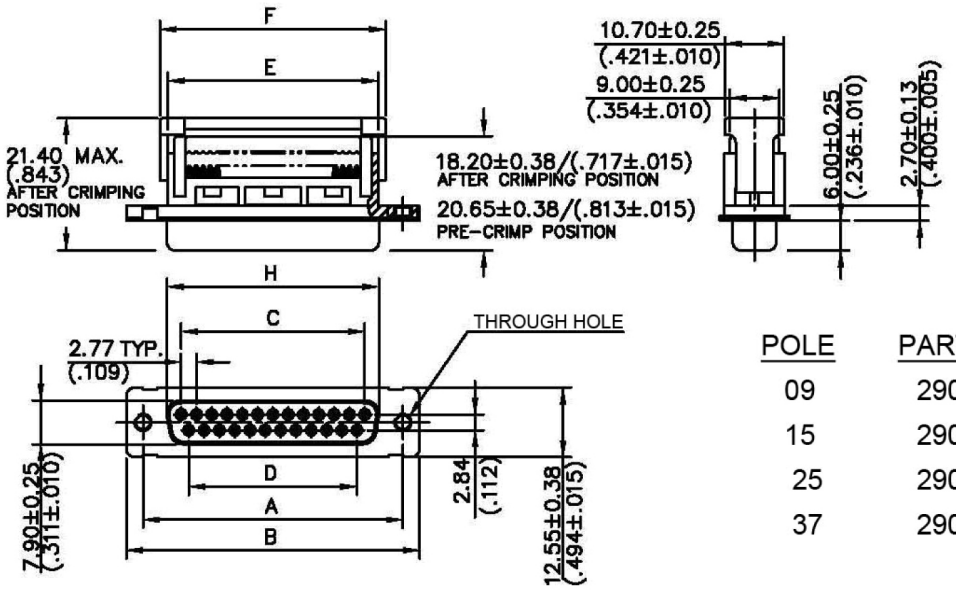
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

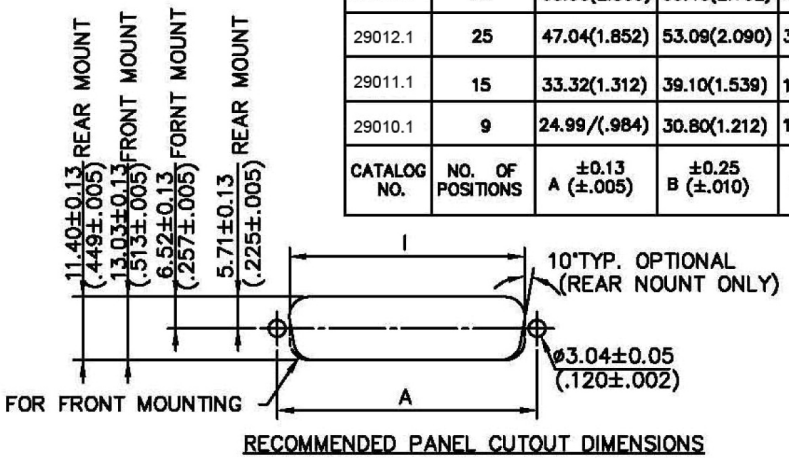
info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

DATENBLATT

DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache Bauform, EDFF 15 LPIII/Z



POLE	PART NO.
09	29010.1
15	29011.1
25	29012.1
37	29013.1



CATALOG NO.	NO. OF POSITIONS	±0.13 A (±.005)	±0.25 B (±.010)	±0.13 C (±.005)	±0.13 D (±.005)	±0.25 E (±.010)	±0.25 F (±.010)
29013.1	37	63.50(2.500)	69.40(2.732)	49.86/(1.963)	47.09/(1.854)	54.60/(2.150)	57.10/(2.248)
29012.1	25	47.04(1.852)	53.09(2.090)	33.24/(1.309)	30.47/(1.200)	38.14/(1.502)	40.90/(1.610)
29011.1	15	33.32(1.312)	39.10(1.539)	19.39/(.763)	16.62/(.654)	24.00/(.945)	26.60/(1.047)
29010.1	9	24.99/(.984)	30.80(1.212)	11.08/(.436)	8.31/(.327)	16.10/(.634)	18.60/(.732)

54.84/(2.159)	59.08/(2.326)	60.73/(2.391)
38.38/(1.511)	42.52/(1.674)	44.27/(1.743)
24.66/(.971)	28.80/(1.134)	30.53/(1.202)
16.33/(.643)	20.47/(.806)	22.20/(.874)
H ±0.25 (±.010)	I± 0.13/(.005) REAR MOUNTIONG	I± 0.13/(.005) FRONT MOUNTING

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION